

半導体ダイシングで長年培ってきたノウハウをコアに、ガラスや石英、セラミックなど脆い、固い、厚い物の切断技術を有します。また、光学ガラスフィルタの製造も手掛けています。人材のアウトソースによる製造一括請負も行います。



ダイシング加工



光学薄膜成形



外観検査工程

得意な技術・製品

- ①長年のノウハウをもとにした半導体(Si)、ガラス、石英、セラミックなど薄い、脆い、固いものの精密切削加工
 - ・全自動ダイサーによる精密切断
 - ・少量試作加工サービス
- ②光学ガラスフィルターの設計(光学設計)と製造(蒸着)
 - ・IRCF、反射防止フィルター、赤外吸収液を用いた IRCF
- ③①②の加工品のソーティング、外観検査、パッキング～出荷までを一貫して行うことが可能です。それらの作業をクリーンルーム(クラス10,000)で行うことが可能です。クリンベンチ、クリンブースも充実しており更なる高品位が実現できます。
- ④データ書き込み
 - ・ロムライターによるデータ書き込みサービス
- ⑤業務請負サービス
 - ・人材のアウトソースによる組み立て工程等の管理も含んだ請負サービス

主要な技術・製品

- ダイシング加工
 - ・Si ウェハー ・光学ガラス ・セラミックスの切削～外観検査～パッキング
- 光学ガラスフィルター
 - ・光学設計 ・光学薄膜の生成(蒸着) ・切削～外観検査～パッキング
 - ・赤外吸収液を用いた NEW タイプの IRCF の製造。⇒従来の IRCF に赤外吸収液をスピンコータにより塗布することで赤外吸収層を設け、ブルーガラスフィルターと同等の赤外吸収による IR カットを実現

■生産拠点、研究体制：東京都 八王子市

■主要設備：蒸着装置 1 台、ダイサー12台、厚物用スライサー 2 台、ピッカー12台、スピナー 5 台、工具顕微鏡 2 台、マイクロスコープ 2 台、走査線顕微鏡(EDX 付属) 1 台、ROM ライター 5 台

■得意な顧客、市場分野：光学メカ、電子部品メカ

■主要取引先(企業名)、顧客構成：(株)東亜理化学研究所、京セラ(株)、日本板硝子(株)、シリコンテクノロジー(株)、ネオフォトニクスセミコンダクタ(合)

■今後開発・獲得したい技術、挑戦したい産業分野

技術→光学部品、セラミックスの研磨加工技術

産業分野→光学系車載分野、光学系セキュリティ分野

▶取得資格、認証(ISO 等)：ISO9001 (光学F 製造) 一般労働者派遣事業許可証

▶海外展開事例、海外拠点：H27年度より台湾、中国、韓国で光学フィルターの販売活動開始

▶受賞履歴(直近 3 ～ 5 年以内)：東京都中小企業技能人材育成大賞 優秀賞(平成28年度)

▶公的支援利用状況(直近 3 ～ 5 年以内)：新製品・新技術開発助成事業、ものづくり・商業・サービス革新補助金

タマエレクトロニクス カブシキガイシャ

多摩エレクトロニクス 株式会社

●資本金:8,000万円 ●従業員数:200人 ●設立年度:1979年

●連絡窓口(名前):加藤 豊 ●所属団体:八王子商工会議所

所在地:〒192-0041 東京都八王子市中野上町4-8-3

電話:042-625-9685

FAX:042-625-6598

<Eメール>

katou689@tama-elec.com

<ホームページ>

http://tama-elec.com/